



2022年1月31日

各位

上場会社名 日進工具株式会社  
 代表者 代表取締役社長 後藤 弘治  
 (コード番号 6157)  
 問合せ先責任者 取締役経営企画室長兼管理部長 戸田 寛  
 (TEL 03-6423-1135)

## 業績予想及び配当予想の修正に関するお知らせ

最近の業績動向を踏まえ、2021年7月30日に公表した業績予想を下記の通り修正いたしましたのでお知らせいたします。

記

### ● 業績予想の修正について

2022年3月期通期連結業績予想数値の修正(2021年4月1日～2022年3月31日)

	売上高	営業利益	経常利益	親会社株主に帰属する当期純利益	1株当たり当期純利益
	百万円	百万円	百万円	百万円	円 銭
前回発表予想(A)	9,170	1,920	1,930	1,330	53.14
今回修正予想(B)	9,520	2,150	2,190	1,530	61.18
増減額(B-A)	350	230	260	200	
増減率(%)	3.8	12.0	13.5	15.0	
(ご参考)前期実績 (2021年3月期)	8,100	1,512	1,712	1,214	48.55

2022年3月期通期個別業績予想数値の修正(2021年4月1日～2022年3月31日)

	売上高	経常利益	当期純利益	1株当たり当期純利益
	百万円	百万円	百万円	円 銭
前回発表予想(A)	7,910	1,620	1,130	45.15
今回修正予想(B)	8,190	1,820	1,270	50.78
増減額(B-A)	280	200	140	
増減率(%)	3.5	12.3	12.4	
(ご参考)前期実績 (2021年3月期)	7,018	1,606	1,170	46.82

2021年4月1日付で、普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。前連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、「1株当たり当期純利益」を算定しております。

#### 修正の理由

新型コロナウイルスの変異株による世界的な感染再拡大に加え、原油価格の高騰や物価上昇等により先行きは不透明な状況ではあるものの、半導体や電子・デバイス関連では、依然として半導体や電子部品の需要は旺盛であり、半導体製造装置関連も好調を維持しています。このような環境の中、当第3四半期連結累計期間においては、精密・微細加工に適した小径工具の需要は底堅く推移し前回予想を上回る業績となっており、期末にかけての状況に大きな変化はないものと判断いたしました。

以上により通期連結業績予想につきましては、連結売上高9,520百万円(前期比17.5%増)、営業利益2,150百万円(同4.2%増)、経常利益2,190百万円(同27.9%増)、親会社株主に帰属する当期純利益1,530百万円(同26.0%増)を見込んでおります。

なお、個別の業績予想に関しましても、上記と同様の理由により、通期個別業績予想につきましては、売上高8,190百万円(前期比16.7%増)、経常利益1,820百万円(同13.3%増)、当期純利益1,270百万円(同8.5%増)を見込んでおります。

※上記の業績予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報及び将来の業績に影響を与える不確実な要因に係る本資料発表日現在における仮定を前提としております。実際の業績は、今後様々な要因によって大きく異なる結果となる可能性があります。

● 配当予想の修正について

	年間配当金				
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	合計
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭
前回予想 (2021年5月14日発表)	—	10.00	—	10.00	20.00
今回修正予想	—	—	—	12.50	22.50
当期実績	—	10.00	—	—	—
前期実績 (2021年3月期)	—	10.00	—	25.00	35.00

2021年4月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。前期実績(2021年3月期)については、当該株式分割前の実際の配当金の額を記載しております。

修正の理由

配当につきましては、安定性・継続性に配慮しつつ、業績動向や配当性向等を総合的に勘案して行うこととしておりますことから、1株当たり期末配当金は2021年5月14日に公表いたしました10円を修正し、通期の業績見通しに鑑み、前期末と同等の1株当たり12円50銭を予定させていただきます。

以 上